

## Verbundprojekt: Energiesparende und vertrauenswürdige Höchstfrequenzelektronik aus Europa - BEYOND5 -; Teilvorhaben: Charakterisierung und Entwurf von FDSOI Millimeterwellen Blöcken

Laufzeit: 01.06.2020 - 29.02.2024 Förderkennzeichen: 16MEE0048S

Koordinator: Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) - Center Nanoelectronic Technologies

BEYOND5 konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der FDX-Technologie in Dresden und entwickelt zusätzlich eine Pilotlinie bei Soitec. Ziel ist, qualitativ hochwertige SOI-Substrate bereitzustellen, um eine hohe Ausbeute und Leistung für 22FD und Next Gen 22FD und darüber hinausgehende Schaltungen zu ermöglichen. Darüber hinaus werden fortgeschrittene Charakterisierungstechniken für FDX durchgeführt, um sowohl die Ausbeute bei der Herstellung als auch die HF-Leistungseigenschaften zu verbessern. BEYOND5 zielt darauf ab, 22FDX-Chips in den autonomen Fahr- und Fluganwendungen zu etablieren, indem verschiedene Arten von Umweltdatenerfassungsgeräten (Radar, Bewegungssensoren) mit Dauerfunktionalität und Prozessoren entwickelt werden, die auf den FDSOI-Plattformen aufbauen und vorteilhafte Leistungsmerkmale für Low-Power-Anwendungen bieten.

Verbund: Energiesparende und vertrauenswürdige Höchstfrequenzelektronik aus Europa

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Redaktion: DLR Projektträger

Länder / Organisationen: Belgien, Schweiz, Frankreich, Israel, Niederlande, Polen, Rumänien, Schweden, Türkei

Themen: Förderung, Information u. Kommunikation

[Zurück](#)

---

### Weitere Informationen